



Пресс-релиз

КОНТАКТ: Всеволод Семенов (495) 641-4550
Vsevolod.Sementsov@Intel.com
Елена Филатова (495) 641-6030
Elena.Filatova@Intel.com
Мария Бородай +38 (044) 490-6357
Mariya.E.Boroday@Intel.com

Intel, Samsung Electronics и TSMC достигли соглашения о переходе на 450-мм подложки

Компании планируют следовать общему графику готовности опытной линии 450-мм подложек

5 мая, 2008 г. – Сегодня корпорации Intel, Samsung Electronics и TSMC объявили о достижении соглашения о необходимости общеотраслевого сотрудничества с целью перехода, начиная с 2012 года, на большие по размеру, 450-мм подложки. Переход на подложки большего диаметра обеспечит дальнейшее развитие полупроводниковой промышленности и позволит сохранить приемлемую структуру расходов на создание интегральных микросхем в будущем.

Компании намерены работать совместно с представителями полупроводниковой промышленности с тем, чтобы обеспечить, к установленному сроку, разработку и тестирование необходимых компонентов, инфраструктуры и производственных мощностей для внедрения опытной линии.

Изготовление микросхем с использованием подложек большего диаметра неизменно позволяет увеличить выпуск полупроводников с минимальными затратами. Общая площадь поверхности 450-мм подложки и количество печатных кристаллов ИС (например, отдельных компьютерных микросхем) более чем в 2 раза превышают соответствующие показатели для 350-мм подложек. Подложки большего диаметра обеспечивают снижение себестоимости изготовления одной микросхемы. Кроме того, благодаря более эффективному использованию энергии, площади подложки и других

ресурсов, подложки большего диаметра помогут снизить общее использование ресурсов, требующихся для изготовления одной микросхемы. К примеру, переход с 200-мм подложек на 300-мм позволил снизить общее количество вредных выбросов, вызывающих глобальное потепление, и потребление воды. С переходом на технологию 450-мм подложек ожидается дальнейшее снижение загрязнения окружающей среды.

«Наша отрасль имеет давнюю историю успешного решения проблем и разработки инноваций, позволивших перейти на подложки большего диаметра, что, в результате, привело к снижению затрат на производство единицы продукции, а также обеспечило общий рост отрасли», – отметил Боб Брук (Bob Bruck), вице-президент и генеральный менеджер отдела Technology Manufacturing Engineering подразделения Technology and Manufacturing Group корпорации Intel. «Мы, вместе с компаниями Samsung и TSMC, считаем, что переход на 450-мм подложки окажется также выгодным для наших заказчиков».

Intel, Samsung и TSMC отмечают, что полупроводниковая промышленность может повысить окупаемость вкладываемых в нее инвестиций и существенно снизить затраты на научные исследования и разработку технологии 450-мм подложек с помощью применения согласованных стандартов, оптимизации изменений инфраструктуры и автоматизации производства 300-мм подложек, а также выполнения общего графика работ. Компании считают также, что подход с позиций сотрудничества поможет свести к минимуму риск и затраты, связанные с переходом на новую технологию.

«Переход на 450-мм подложки принесет пользу всей экосистеме производства интегральных микросхем. Intel, Samsung и TSMC намерены работать совместно с поставщиками и другими производителями полупроводников с целью активной разработки технологии производства с использованием 450-мм подложек», – отметил Чеонг-Ву Бьун (Cheong-Woo Byun), старший вице-президент центра Memory Manufacturing Operation компании Samsung Electronics.

Раньше миграция на подложки большего размера традиционно начиналась каждые 10 лет с момента последнего перехода. К примеру, переход отрасли на 300-мм подложки в 2001 году произошел спустя десятилетие с момента ввода в действие первых производственных мощностей на основе 200-мм подложек в 1991 году.

Придерживаясь исторически сложившегося темпа развития отрасли, Intel, Samsung и TSMC считают 2012 год подходящим временем для начала перехода на

450-мм подложки. Принимая во внимание сложность интеграции всех компонентов для перехода на данный размер подложек, компании полагают, что согласованная оценка намеченного графика является критически важной для обеспечения общеотраслевой готовности.

«В будущем потребуется решить проблему повышения себестоимости вследствие сложности внедрения передовых технологий, – заметил Марк Лиу (Mark Liu), старший вице-президент подразделения Advanced Technology Business компании TSMC. - Intel, Samsung и TSMC считают, что переход на 450-мм подложки является потенциальным решением, позволяющим сохранить приемлемую для отрасли структуру расходов».

Intel, Samsung и TSMC продолжают сотрудничество с Международным консорциумом Sematech (ISMI), так как данная организация играет важнейшую роль в координации усилий отрасли в вопросе поставок 450-мм подложек, определения стандартов, а также разработки испытательных стендов для оборудования.

О корпорации Intel

Корпорация Intel, ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов, разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества жизни людей и совершенствование методов их работы. Дополнительную информацию о корпорации Intel можно найти на Web-сайте www.intel.com/pressroom, на русскоязычном Web-сервере компании Intel (<http://www.intel.ru>), а также на сайте <http://blogs.intel.com>.

О компании Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics Co. Ltd – мировой лидер в области производства полупроводников, телекоммуникационного оборудования, цифровых накопителей и технологии объединенных цифровых решений. Ее общий объем продаж в 2007 году достиг 103,4 млрд. долларов США. Штат сотрудников компании составляет 150 тыс. человек в 134 офисах в 62 странах мира. В состав Samsung Electronics входят пять основных подразделений: Digital Media Business, LCD Business, Semiconductor Business, Telecommunication Business и Digital Appliance Business. Общеизвестно являясь самым быстрорастущим глобальным брендом, Samsung Electronics лидирует на рынке

цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных телефонов и TFT-дисплеев. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите Web-сайт компании www.samsung.com.

О компании TSMC

TSMC – крупнейшее в мире специализированное предприятие по выпуску интегральных схем, владеющее одними из лучших в отрасли производственными технологиями и самым большим портфелем апробированных на практике библиотек, интеллектуальной собственности, инструментальных средств проектирования и эталонных технологических процессов. Общие производственные мощности компании в 2006 году превысили восемь миллионов подложек (в пересчете на 8-дюймовые подложки). Компании принадлежат два завода GigaFab, выпускающие передовые 12-дюймовые подложки, четыре – выпускающих восьмидюймовые и один – изготавливающий шестидюймовые, кроме того, в ее полной собственности находятся две дочерние компании WaferTech и TSMC (Шанхай), она также имеет долю в совместном предприятии SSMC. Компания TSMC стала первым производителем, освоившим выпуск интегральных схем по 65-нм технологическому процессу. Штаб-квартира компании расположена в г.Синьчу (Тайвань). Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите Web-сайт компании <http://www.tsmc.com>.

Intel и логотип Intel являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.

***Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.**